

場所

NANOBIC 会議室 2

(川崎市幸区新川崎7-7 新川崎・創造のもり JR新川崎駅から徒歩10分)

講師

松垣 仁 先生

((地独)神奈川県立産業技術総合研究所)

<開催日>

12/19(木)

※講習1時間、実習2時間

13:30-16:30

実習内容

ダイシングソーを使った基板切断の原理について講習します。 また、実際に装置を使った実習会も行ないます。

実習機器

ダイシングソー DAD522 株式会社ディスコ 製造

\* シリコン・ガラス・セラミックなどの被加工物をブレードを用いて高精度に切断できます。 機器詳細仕様は「NANOBICオープンラボ」ホームページ <a href="https://open-labo.skr.jp/">https://open-labo.skr.jp/</a> の設備一覧をご覧下さい。

### OF THE PROPERTY OF THE P

慶應、早稲田、科学大、東大からなる4大学ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアムでは、川崎市、KISTECと連携し、 産学連携による新しい技術や産業の創出を図るため、新川崎・創造のもりのナノ・マイクロ産学官共同研究施設 「NANOBIC」において、4大学の先端機器の利用開放を行なっています。今後、更に効果的に機器をご活用いただくため、 企業や大学の方を対象とした「ウェーハ切断 講習・実習会」を開催しますのでご参加ください。

なお、本講習・実習会は日本工学会ECE(高度技術者教育)プログラムの認定のもと実施しており、 所期の成績を収めた方には修了証とNano Fab Square Award各賞を授与いたします。

定員:先着5名程度 参加費:13,000円 主催:4大学ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアム、

(地独)神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC), 川崎市

申込:下記申込フォームよりお申込みください。 https://forms.gle/6gTKrQipc7DrACPY6



問い合わせ先